

株式会社エンプラス

P R E S E N T A T I O N

2009年3月期
第2四半期決算説明会

2008年10月29日

- 取締役 経営戦略本部長
- 酒井 崇

2009年3月期 経営基本方針

1. 基幹事業（エンブラ事業）による
グループ成長の牽引
2. オプト・グループ事業の成長軌道への
早期復帰・強化
3. 開発ビジョンの構築と新規事業の強化・育成
4. グローバルなコスト競争力強化
5. スピード経営の実践
6. 内部統制システムの確立

当上半期に実施した主な施策



- 企業力強化に向けた基盤づくり
 1. 金型生産体制の強化拡充
 2. オプト事業のベトナム生産移管
 3. 半導体機器事業の再構築
 4. LED関連事業の設立
 5. (株)エンプラス ディスプレイ デバイスの清算
- 自己株式の市場買付 (555,200株)
保有自己株式数 4,127,136株

2



P R E S E N T A T I O N

上半期決算実績

当上半期決算実績				(単位：億円)		tenplas	
	第1四半期 実績	第2四半期 実績	当上半期 実績	前上半期 実績			
売上高 (原価率)	66.2 (73.1%)	60.2 (72.7%)	126.4 (72.9%)	144.9 (70.3%)			
営業利益	1.1	1.7	2.9	5.2			
経常利益	0.0	0.9	1.0	5.4			
当期純利益	2.0	8.9	10.9	12.2			
1株当たり当期純利益	11.83円	53.06円	64.47円	63.95円			
1株当たり配当	-	-	5.00円	5.00円			

4

セグメント別 売上高実績				(単位：億円)		tenplas	
	第1四半期 実績	第2四半期 実績	当上半期 実績	前上半期 実績			
エンブラ事業	37.6	35.0	72.7	75.7			
半導体機器事業	14.9	13.5	28.4	38.0			
LED関連事業 (旧液晶関連事業)	4.1	2.3	6.5	14.0			
オプト事業	9.4	9.3	18.7	17.0			
合計	66.2	60.2	126.4	144.9			

5

上半期決算総括



▶ 半導体機器・LED関連事業の大幅減収

- ◆ 半導体機器事業 前年同期比 25%
- ◆ LED関連事業 前年同期比 54%

- ▶ 棚卸資産評価方法の変更 57百万円
- ▶ 事業再構築（EDDの清算） 180百万円
- ▶ 投資有価証券評価損 304百万円
- ▶ 繰延税金資産の取崩し 141百万円
- ▶ 内部統制関連費用の増加 50百万円

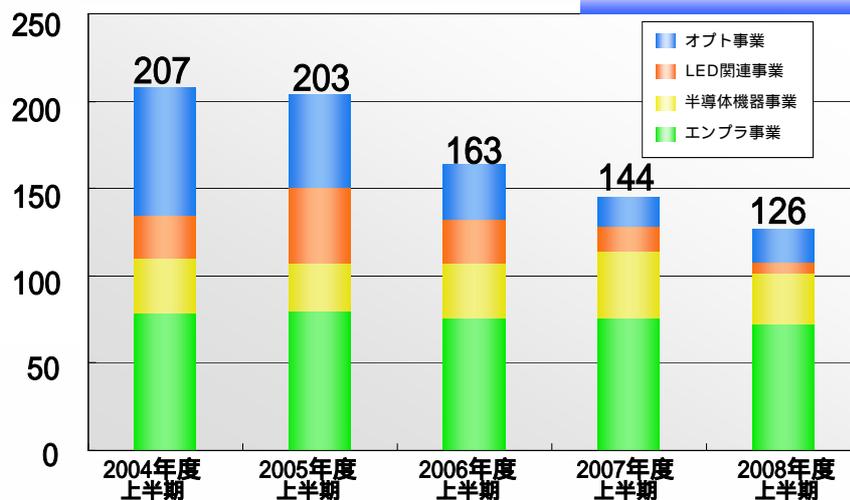
6

上半期実績推移



（億円）

売上高



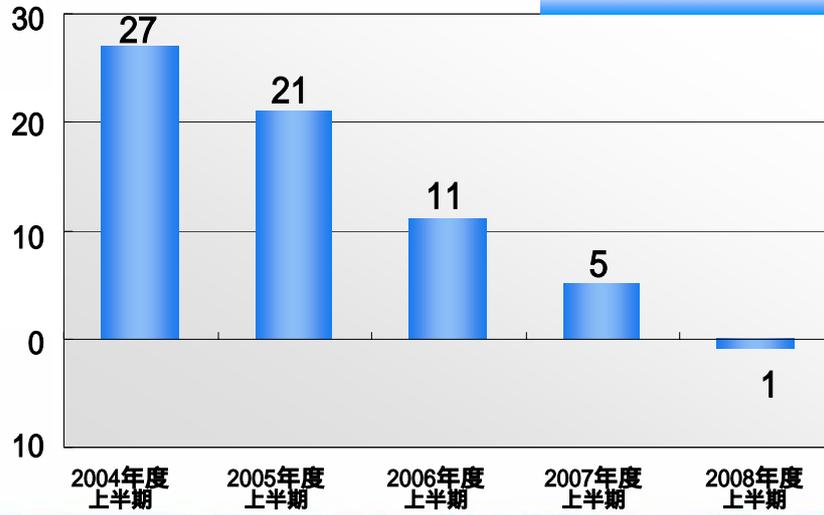
7

上半期実績推移



(億円)

経常利益



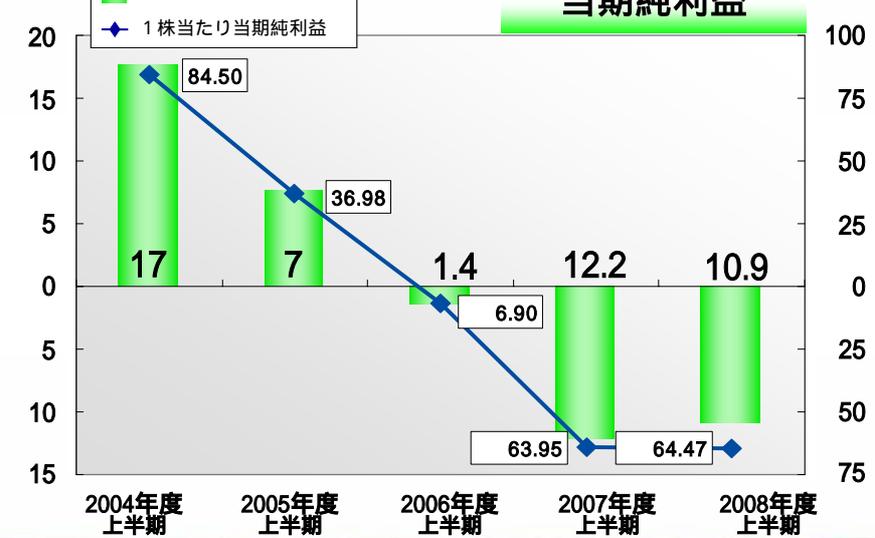
8

上半期実績推移

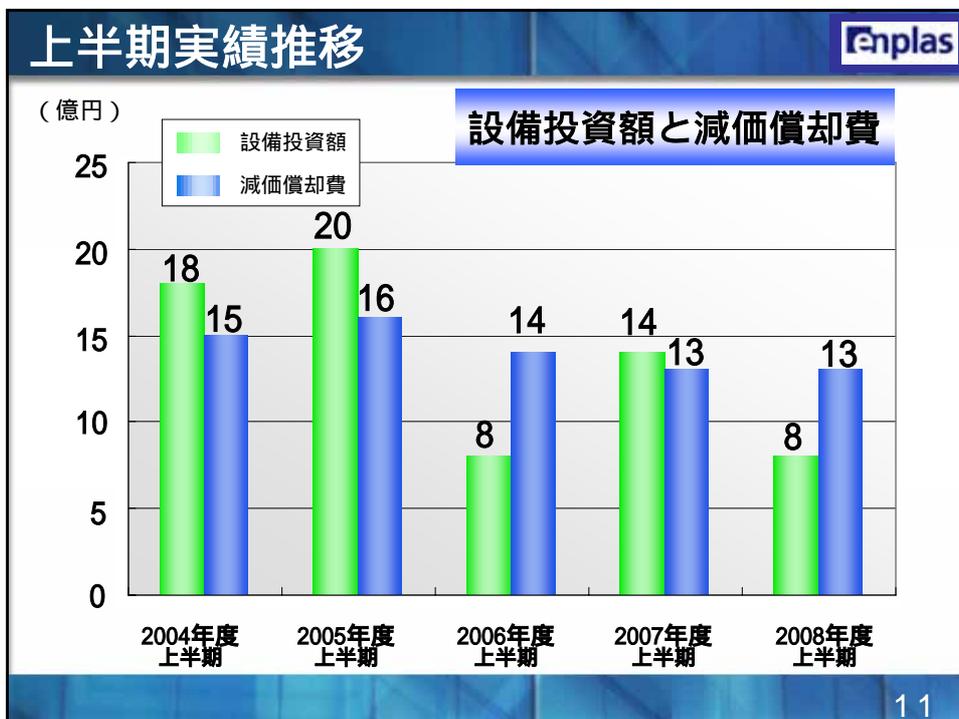
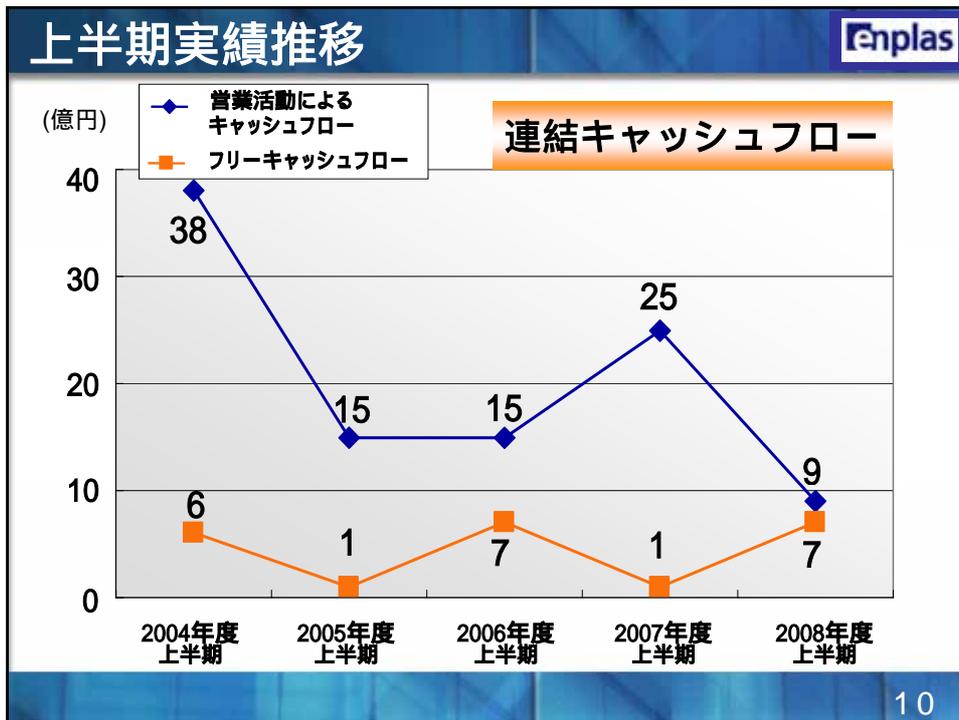


(億円)

当期純利益



9





2009年3月期 通期修正計画		Enplas	
	当上半期 実績	通期 修正計画	通期 期初計画
	(単位：億円)		
売上高	126.4	260.0	290.0
(原価率)	(72.9%)	(72.3%)	(68.6%)
営業利益	2.9	5.0	8.0
経常利益	1.0	2.0	10.0
当期純利益	10.9	6.0	2.0
1株当たり当期純利益	64.47円	35.76円	11.54円
1株当たり配当	5.00円	10.00円	10.00円

セグメント別 売上高修正計画



(単位：億円)

	当上半期 実績	通期 修正計画	第1四半期 通期修正計画	通期 期初計画
エンブラ事業	72.7	150.0	156.0	160.0
半導体機器事業	28.4	58.0	72.0	72.0
LED関連事業	6.5	12.0	16.0	20.0
オプト事業	18.7	40.0	46.0	38.0
合計	126.4	260.0	290.0	290.0

14

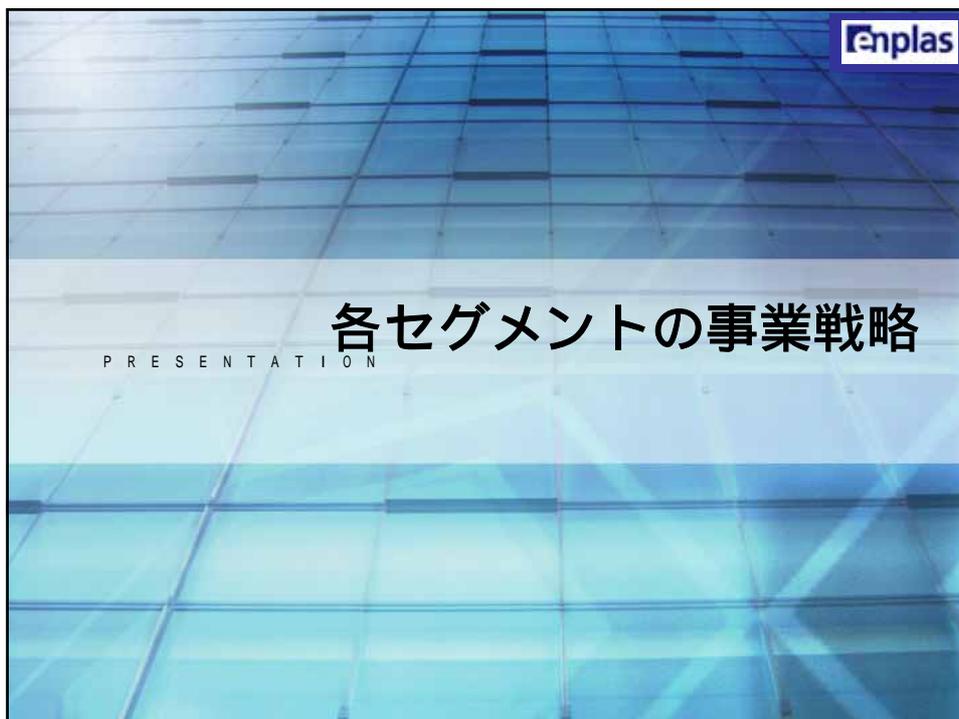
参考指標



(単位：億円)

	2008年3月期 実績	当期 修正計画	当上半期 実績
設備投資額	27.1	18.0	8.8
減価償却費	27.5	26.0	13.6
研究開発費 (売上高比)	12.3 (4.3%)	10.0 (3.8%)	5.3 (4.2%)

15



エンプラ事業 Enplas

前上半期 実績	前下半期 実績	当上半期 実績	当下半期 計画
75.7	75.8	72.7	77.3

- グローバル顧客戦略の推進
- 金型生産体制の再構築
- 営業開発部門の再編・特化

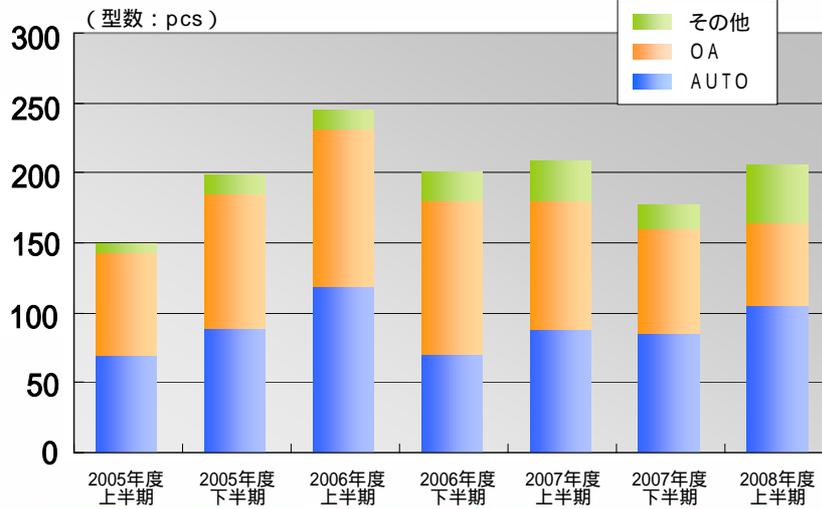


17

エンプラ事業の動向



金型受注状況推移



新事業-自動車関連-



自動車部品事業の展望

電気自動車とプラグインハイブリッド車が主流
10年後



プラグインハイブリッドへ
5年後



既存エンジンの燃費改善
現在

ハイブリッド車の増加
電気自動車も出現

- | | |
|----------|---|
| 事業 | 自動車用プラスチックギヤ及び機構部品 |
| コアコンピタンス | プラスチックギヤ設計
高精度ギヤ金型
高品質ギヤ成形
高精度機構部品成形 |

- | | |
|----------|---|
| 事業 | 高性能機構部品
車載センサー(電子、光系)用機能部品 |
| コアコンピタンス | 耐熱、高強度機構部品技術
微細、高精度成形
耐熱、高精度部品用金型(スーパーエンブラ用ホットランナー) |

- | | |
|----------|--|
| 事業 | 高効率動力伝達機構部品
特殊成形高機能部品
車載用 スモールオプティクス |
| コアコンピタンス | 動力伝達最適化設計
超微細高精度部品用金型
特殊成形技術(?)
耐熱、高信頼性光学部品 |

車載電池の進化

燃費、安全性の追求 センサーの増加
(画像処理のためのカメラと表示のためのディスプレイも必須)

利便よりも軽量化

環境ありきの開発が大前提の時代へ

→ ハイブリッド車は環境と快適な走りを両立

半導体機器事業



前上半期
実績

前下半期
実績

当上半期
実績

当下半期
計画

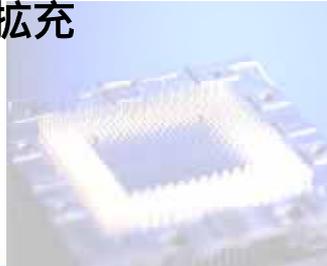
38.0

34.6

28.4

29.6

- テストソケットビジネスの拡充
- 更なるコスト対応力の強化



20

半導体機器事業



事業再構築

— 本社移転 —

時期： 2008年11月

場所： 川口市上青木

目的： 本社機能を、先端技術開発の推進及び加工技術の社内蓄積を目的とした技術開発センターと合体し、技術開発の推進やビジネスの拡充を図る。



21

LED関連事業



前上半期
実績

前下半期
実績

当上半期
実績

当下半期
計画

14.0

16.3

6.5

5.5

➤ 本格的事業化の推進

1. Light Enhancer Capの拡販
2. 導光板事業の黒字化と次世代製品の量産化
3. 新製品開発



22

LED関連事業



消費電力量の削減

LED拡散レンズ採用事例(看板サイズ:2,800mm x 1,400mm)
 年間稼働 : 1日12時間点灯 = 4,380h
 電気代換算: 23円/kWh
 (業務用電力: 日本照明器具工業会出典)



蛍光管

蛍光管本数: 40W x 12本
20W x 6本



約20%DOWN

LEDのみ
LED個数: 1,400個



約60%DOWN!!

LED拡散レンズ使用
LED個数: 576個

年間使用電力

3,679kWh

2,943kWh

1,489kWh

年間電気料金

84,617円

67,689円

34,247円

年間CO2量

2,042Kg

1,633Kg

826Kg

23

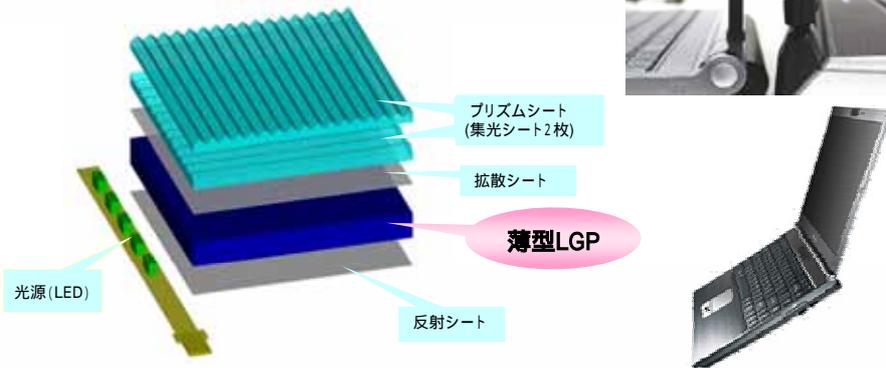
LED関連事業

enplas

LED光源対応(導光方式)

薄肉SP-LGP方式

- 高輝度・薄型・低消費電力・低コスト化を実現 -



ノートPCから携帯電話等、中小型液晶ディスプレイ向け導光板

24

オプト事業

enplas

前上半期
実績

前下半期
実績

当上半期
実績

当下半期
計画

17.0

19.3

18.7

21.3

グローバル営業・生産体制

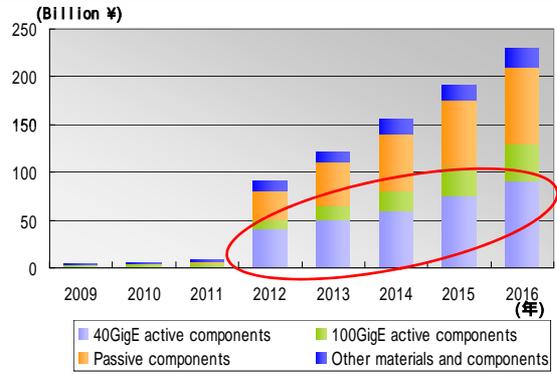
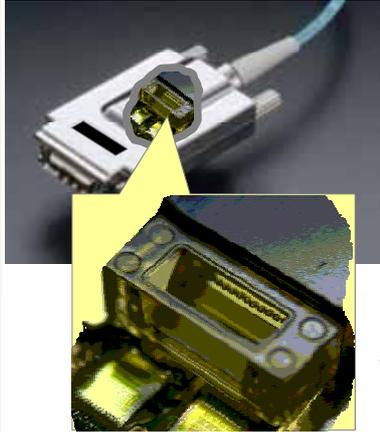
- A I S : 戦略製品への特化
- O P U : 最適地生産による製造原価の低減と市場シェア拡大
- O F C : 次世代通信規格への対応と新製品開発

25

オプト事業



次世代通信規格市場



光アクティブケーブル(Infiniband Cable)用

「光減衰レンズアレー」

フィルタ機能を付加したレンズアレー



ご清聴有難うございました。

P R E S E N T A T I O N

株式会社エンプラス